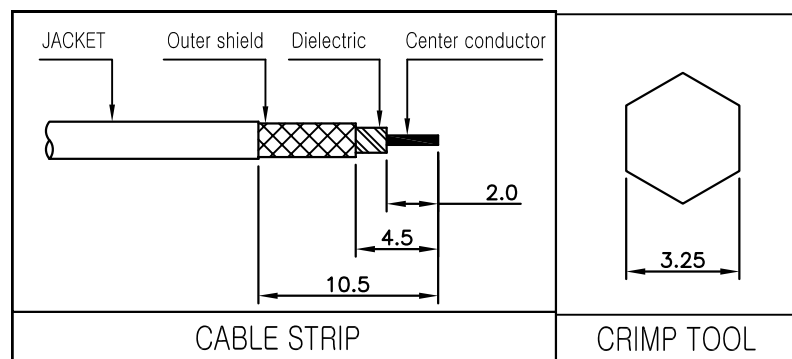
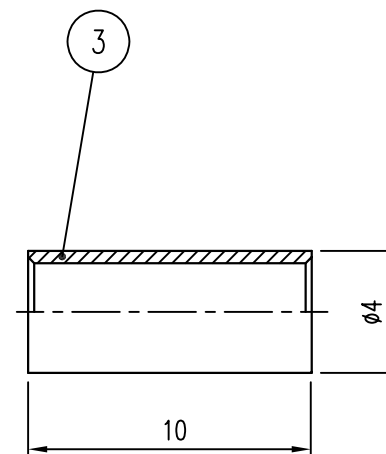
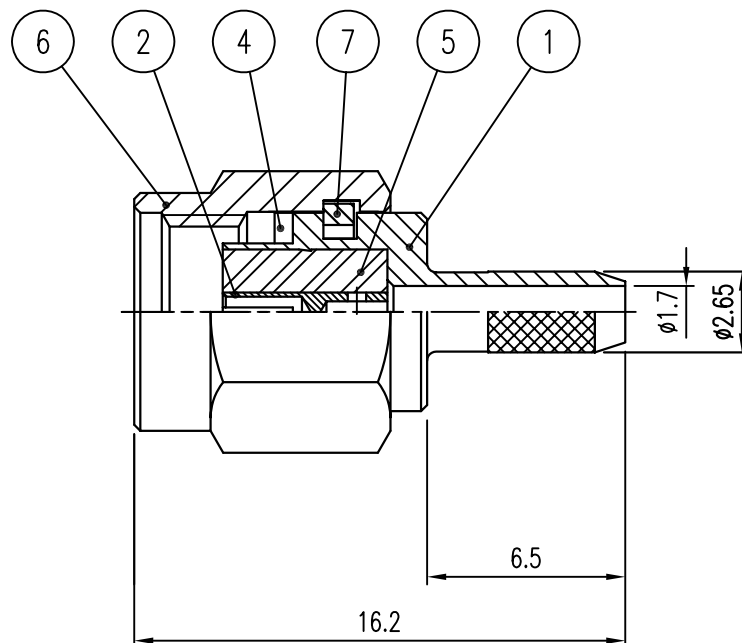


수 정 내 용				
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
1 R				2007. 05. 16.
1	[실변치리No.201201-0010] BODY,콜연체 구성 변경	I.C.KIM	J.H.YOUN	2012. 01. 26.
2	교체사 캐aket 일차부 배다 부러짐 현상 개편으로 인한 R추가	S.Y.EUN	I.C.KIM	2020. 12. 08.
3	[실변No.202203-0008] PIPE 공용화 부품 적용으로 인한 코드 변경	S.Y.EUN	S.H.KIM	2022. 03. 15.



1	7	SPRING RING	1	SUS	부동태 처리	DSR00002-5/1
	6	CAP	1	MBsBD	Gold Plate	DCU00005-5/1
	5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN01667-N/1 DIN00101-N/1
	4	GASKET	1	SILICONE RUB		DGK00004-N/1
3	3	FERRULE	1	MBsBD	Nickel Plate Gold Plate	DFE00034-5/1 DFE00031-5/1
	2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT02243-5/1
1	1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00128-5/4 DBD00128-5/2 DBD00128-5/1

대체가능재질	품번	품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일	2022. 03. 15.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.			
	승인	S. H. KIM					
재질	검도			도명 SMA-PC-316-R.P			
열처리	제도	S. Y. EUN					
보호피막처리	작성부서	연 구 소		A4	도번 CN00971-7/1 K314-001-101		
	적도	4/1	단위 mm				